

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2026-025

通富微电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 1,517,596,912 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.81 元（含税），本次不进行资本公积转增股本，不送红股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通富微电	股票代码	002156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋澍	丁燕	
办公地址	江苏省南通市崇川路 288 号	江苏省南通市崇川路 288 号	
传真	0513-85058929	0513-85058929	
电话	0513-85058919	0513-85058919	
电子信箱	tfme_stock@tfme.com	tfme_stock@tfme.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 报告期内公司从事的主要业务

公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。面对 2025 年半导体行业强势复苏以及结构性分化的格局，公司坚持“快决策、强分析、精运营”，在诸多挑战下，积极调控，抓住市场机遇。2025 年，公司营收与利润双双创出历史新高，经营质效迈上新台阶，续写高质量发展新篇章。

2025 年，公司坚持以方案竞争力为中心，系统化推进通富标准方案；紧扣产业发展大势，持续加大投入，提升投资有效性；扎实推进降本工作，持续提升成本管控能力；聚焦生产效率、交付能力、工程能力，强化在市场上的竞争优势；狠抓质量和交付两个环节，为高质量运营保驾护航；优化人员结构，推动人才梯队建设。通过上述举措，推动组织高效运转，资产运营效率不断提升。2025 年，公司实现营业收入 279.21 亿元，同比增长 16.92%。根据芯思想研究院发布的 2025 年全球委外封测榜单，公司在全球前十大封测企业中排名不变。

2025 年，公司实现归属于母公司股东的净利润 12.19 亿元，同比增长 79.86%。2025 年，全球半导体产业在人工智能、高性能计算、数据中心基础设施建设等需求的拉动下，延续增长态势，逻辑 IC 与存储芯片尤其涨势强劲。报告期内，公司积极进取，产能利用率提升，营业收入增幅上升，特别是中高端产品营业收入明显增加。同时，得益于加强经营管理及成本费用的管控，公司整体效益显著提升。此外，公司准确把握产业发展趋势，围绕供应链及上下游布局产业投资，取得了较好的投资收益，增厚了公司 2025 年业绩。

2025 年，我们经历了全球产业链震荡、行业需求结构性波动及技术迭代加速等多重考验，也曾面临核心材料供应紧张、市场竞争激烈的严峻挑战。面对这些前所未有的挑战，全体通富人苦练内功，攻坚克难，一腔热血，一路前行，同心聚力，躬身实干，功不唐捐，玉汝于成。圆满完成了各项核心目标，以扎实的业绩赢得客户、员工、股东的满意与信任！

(2) 报告期内公司所处行业情况

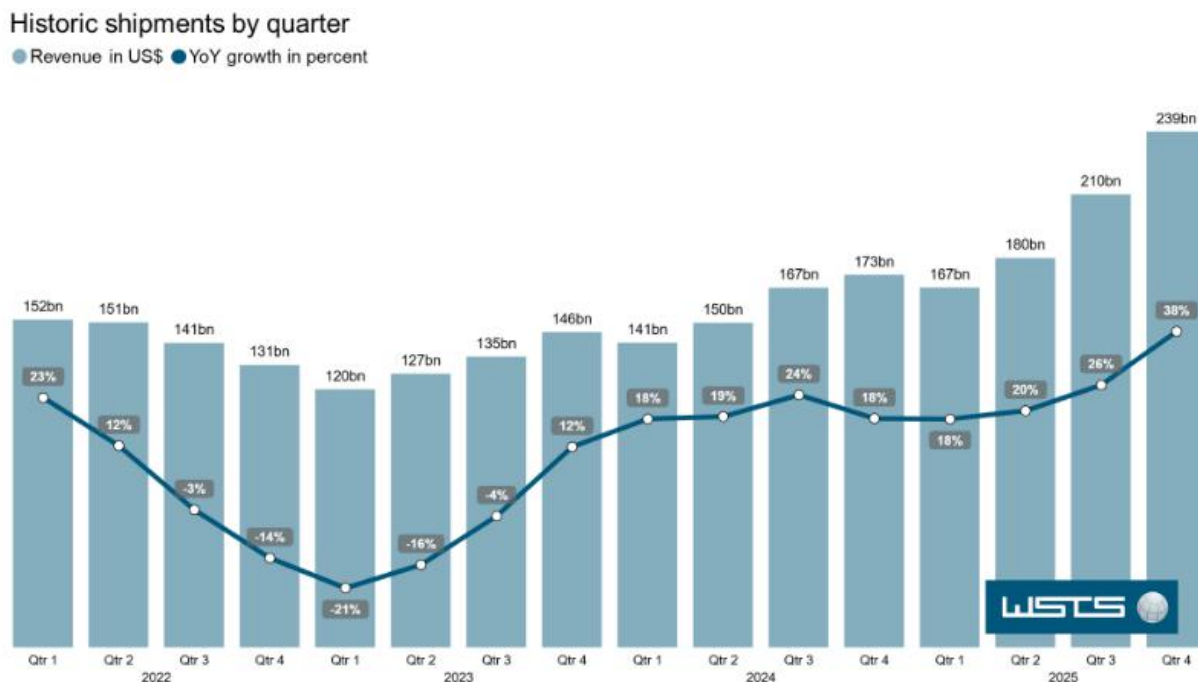
2025 年，半导体产业打破了传统周期性波动规律，进入结构性增长新阶段。不同于以往依赖消费电子需求的增长模式，当前 AI 与数据中心已成为核心增长引擎。这一年被视为市场的“结构成型年”，其背后是政策扶持、AI 需求爆发、存储芯片行业景气度提升以及国产替代进程显著提速等多重因素的共振与合力。人工智能的浪潮正以前所未有的深度和广度重塑全球半导体产业，其对算力与存储的渴求，进一步打开行业成长空间，为半导体产业高质量增长注入最强劲动能。

1) 全球半导体市场处于强劲增长周期

根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2025 年全球半导体销售额达到 7,956 亿美元，同比增长 26.2%，创下行业历史上最强劲的年度增长之一。这一增长势头在年内持续加速，2025 年第四季度行业营收达到 2,389 亿美元，较

2024 年第四季度增长 38.4%，反映出多个关键应用领域，特别是数据中心基础设施和人工智能相关系统的强劲需求。美国半导体行业协会（SIA）总裁兼首席执行官 John Neuffer 表示：“全球半导体行业在 2025 年创下了有史以来最高的年度销售额，接近 8,000 亿美元，预计 2026 年全球销售额将达到约 1 万亿美元。” “半导体是几乎所有现代技术的基础，而人工智能、物联网、6G、自动驾驶等新兴技术将继续推动芯片的强劲需求。”

图表：2022-2025 年按季度划分的全球半导体市场规模情况（单位：十亿美元）



来源：WSTS

2025 年，从细分市场表现来看，逻辑产品增长 39.9%至 3,019 亿美元，存储器增长 34.8%至 2,231 亿美元，这两个品类合计贡献了总量的 2/3 以上，也基本代表了本轮周期的核心驱动力为 AI 算力的基础设施建设。

2025 年，全球科技与半导体行业的核心叙事已从“人工智能应用探索”全面转向“人工智能基础设施建设”。一个由 GPU、加速器、高带宽内存和先进封装构成的、规模数千万美元的 AI 算力超级周期，正以前所未有的资本强度重塑产业格局。行业的增长驱动力、竞争焦点与估值体系均发生着根本性转变。

据 Gartner 数据显示，2025 年全球集成电路封测市场规模预计达 890 亿美元，同比增长 8.5%，2025 年至 2029 年复合年均增长率预计为 10%。AI、汽车电子、数据中心为三大增量引擎，先进封装占比提升但贸易摩擦与材料依赖进口形成短期扰动。根据 Yole 测算，2025 年先进封装市场规模将达 569 亿美元，同比增长 9.6%，占比将首次超过传统封装达 51%，标志着全球封装技术正式进入先进封装主导时代。

2) 中国半导体市场延续高增长势头，外贸出口增长强劲

2025 年，中国半导体行业延续高速发展态势，全年销售额首次突破 2,000 亿美元整数关口，超过 2,100 亿美元，同

比增速超过 15%，占全球半导体销售总额比重保持在三成左右，该销售规模刷新了历史纪录。据海关总署统计，2025 年我国集成电路出口 2,019 亿美元，同比增长 26.8%，创下历史新高，实现了连续二年同比增长。2025 年 12 月，我国集成电路出口 218.6 亿美元，同比增长 47.8%，创月度出口新高，并保持连续 26 个月同比增长。对比 2025 年同期，2026 年前两月集成电路出口增速从 11.9% 跃升至 72.6%。国内外政策频繁调整促使下游厂商备货周期提前，叠加人工智能相关半导体成为核心驱动力，共同支撑全球半导体市场和我国集成电路出口的增长。

中国机电商会电子信息分会认为，“十四五”期间，电子信息行业进出口实现显著增长，成为稳外贸、促产业升级的重要引擎。这一增长态势得益于国家政策鼓励、全球需求增长与我国产业竞争力提升等多重因素。“十五五”时期，中国将继续推动集成电路、高端芯片等关键核心技术攻关，强化行业产业链供应链韧性与安全，鼓励高附加值产品出口与关键设备、材料进口，提升自主品牌出口占比。与此同时，随着 AI 等技术与终端产品融合水平不断提升，集成电路、新型显示、智能手机、计算机等产品迭代升级步伐加快，也将为行业外贸增长注入新动能。2026 年，中国企业正将这些产业优势转化为开拓国际市场的实际行动，通过多重路径稳步提升自主水平、巩固新兴市场份额，以贸易投资一体化深耕国际市场，不断增强行业进出口韧性，推动对外贸易高质量发展。同时，中国集成电路的出口有望延续高增长势头，进一步巩固中国在全球半导体产业中的重要地位。

3) 人工智能与汽车电子的飞速演进，推动半导体行业向多元化与结构化发展

半导体是电子信息产业的核心基石，应用领域覆盖消费电子、汽车电子、通信与网络、医疗电子、人工智能和工业控制等几乎所有电子设备及新兴产业赛道。近年来，生成式 AI 的出现为人工智能产业带来了巨大发展，而人工智能正从需求端、技术端、供给端等全方位重塑半导体产业，其中对算力的需求极大的推动了对半导体产业的需求，算力需求的增长带动了 AI 服务器及数据中心的快速发展，其中 AI 服务主要由 AI 芯片、存储、连接部件等构成，AI 同时推动了这些方面需求并显著提升了每个部件内半导体含量。汽车电子方面，新能源汽车快速发展，车载电子相关部件覆盖车用功率半导体、传感器、计算芯片、智能驾驶、智能座舱、动力控制系统等多个方面，电车半导体需求较传统油车大幅提升，根据乘联会数据，2025 年全球新能源汽车销量约 2,280 万辆，同比增长 28.5%，市场渗透率提升至 24.8%，其中汽车电子部分，根据 Mordor Intelligence 数据，汽车半导体市场规模在 2025 年达到 1,004.8 亿美元，预计以 7.29% 的复合年均增长率扩张，市场价值将提升至 2030 年的 1,428.7 亿美元。

整体来看，与以往行业复苏周期不同，本轮半导体行业的复苏主要由人工智能与汽车电子两大领域驱动。特别是人工智能的快速发展，正推动半导体从电子产品的关键组件，演进为几乎所有行业的底层基础设施，从而推动全球半导体行业需求的多元化与结构化演进；同时，在半导体国产化替代带动下，随着国内产业链布局逐步完善，先进技术持续突破，国内半导体海外需求亦将不断转移至国内。

4) 政策组合拳落地，为产业高质量发展保驾护航

2025 年，国家及地方纷纷出台政策，为半导体自主创新与高质量发展筑牢制度保障。

2025 年 1 月，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，覆盖集成电路设计、制造、封测、装备、材料全环节，明确税收优惠、资金支持、人才引进、国际合作等一揽子措施，不分所有制平等享受政策红利，为产业长期稳定发展提供顶层指引。

2025 年 4 月，国家发改委、工信部等部门启动 2025 年集成电路企业税收优惠清单申报工作，对先进工艺、特色工艺、先进封测及关键原材料企业实施所得税减免、研发费用加计扣除等优惠，精准降低企业负担，激发创新活力。

2025 年 10 月，国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，这一政策的落地，实现了以市场需求牵引产业升级。

一系列政策协同发力，从顶层规划、税收资金到市场应用形成闭环支撑，有力推动我国半导体产业向自主可控、高端化、提升竞争力加速迈进。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	47,266,459,661.25	39,340,187,388.18	20.15%	34,877,709,853.20
归属于上市公司股东的净资产	15,493,795,234.49	14,690,833,021.88	5.47%	13,917,141,774.57
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	27,921,424,656.15	23,881,680,710.28	16.92%	22,269,283,210.86
归属于上市公司股东的净利润	1,218,708,143.38	677,588,312.75	79.86%	169,438,510.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	840,574,217.79	621,087,213.82	35.34%	59,483,489.23
经营活动产生的现金流量净额	6,965,701,919.01	3,877,209,658.23	79.66%	4,292,652,175.28
基本每股收益（元/股）	0.80	0.45	77.78%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.80	0.45	77.78%	0.11
加权平均净资产收益率	8.08%	4.75%	3.33%	1.22%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,092,434,550.56	6,945,811,605.71	7,078,012,733.14	7,805,165,766.74
归属于上市公司股东的净利润	101,389,231.19	310,702,922.93	448,398,925.70	358,217,063.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,151,659.59	316,285,827.22	357,570,702.76	62,566,028.22
经营活动产生的现金流量净额	1,458,295,893.72	1,021,886,617.54	2,986,070,276.89	1,499,449,130.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	281,833	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	350,783	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
南通华达微电子集团股份有限公司	境内非国有法人	19.79%	300,344,715	0	质押	43,810,000	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	6.67%	101,270,409	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	6.43%	97,603,736	0	不适用	0	
苏州园丰资本管理有限公司—苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）	其他	1.89%	28,637,265	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.18%	17,915,620	0	不适用	0	

中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.96%	14,507,162	0	不适用	0
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	0.95%	14,458,169	0	不适用	0
国泰海通证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	7,558,424	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	4,387,858	0	不适用	0
王金根	境内自然人	0.25%	3,811,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第 1 大股东与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	第 10 大股东王金根通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,568,000 股公司股票。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

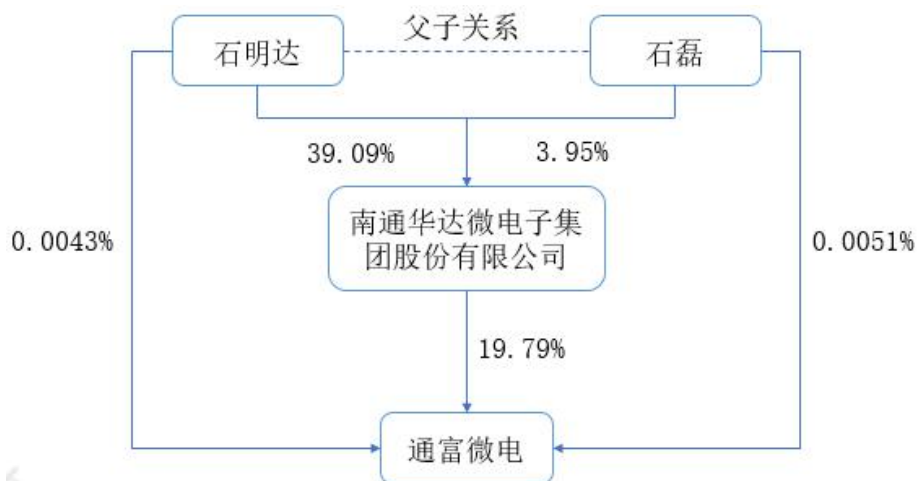
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

无

通富微电子股份有限公司

董事长：石磊

2026 年 4 月 15 日